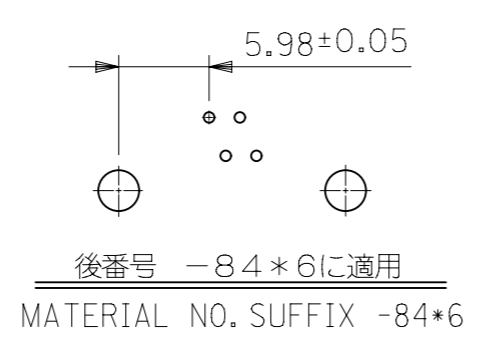
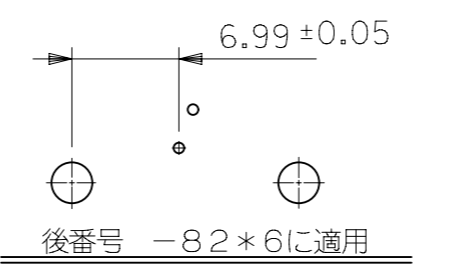
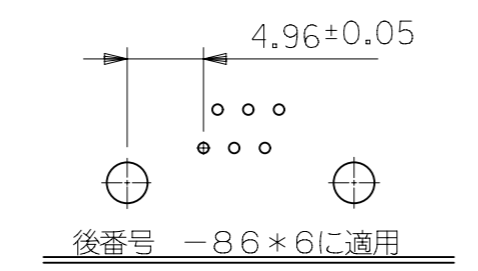
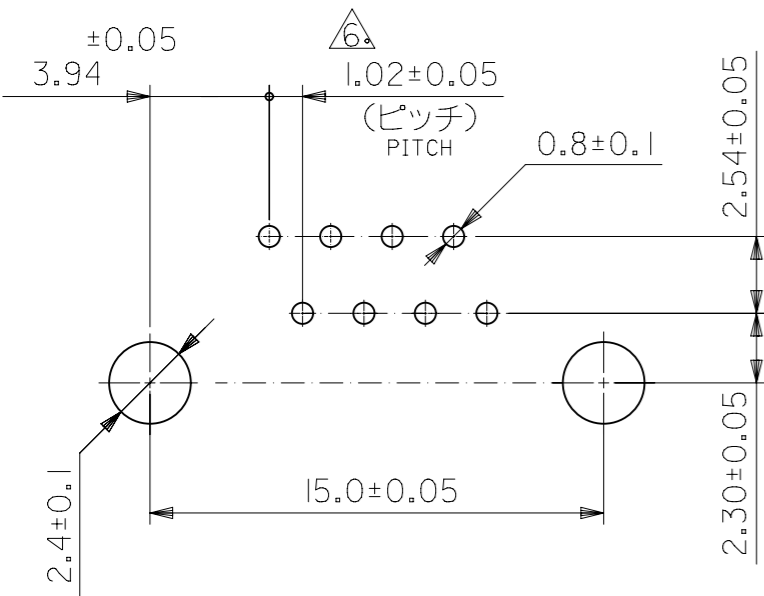


注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA: TIN 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0µmMIN.
- 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- △ 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. 緑色: 0.38µmMIN.
YELLOW: 0.1µmMIN. GREEN: 0.38µmMIN.
オレンジ色: 0.76µmMIN. 無色: 1.27µmMIN.
ORANGE: 0.76µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
- △ 公差非累積。
NON-ACCUMULATIVE
- 本製品は 52018-8**5 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-8**5.



後番号 -88*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -88*6

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

52018-8**6	8	8	7.11	1.27	52018-8846
MODEL NO.	POSITION	極数	(A)	金メッキ厚(µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.) (µmMIN.)	製品番号 MATERIAL No.

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE 4:1		CURRENT REV DESC:		molex	
10 UNDER 未満	±0.2	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		EC NO: 628958			
10 OVER 以上	±0.25	4 PLACES	±	DRWN: AKUMAR19 2018/08/28		MODULAR JACK HSG ASSY -LEAD FREE-	
30 OVER 以上	±0.3	3 PLACES	±	CHK'D: GGA 2020/01/16		PRODUCT CUSTOMER DRAWING	
ANGLE 角度	±3°	2 PLACES	±	APPR: GGA 2020/01/16		DOCUMENT NUMBER	
		1 PLACE	±	INITIAL REVISION:		DOC TYPE DOC PART REVISION	
		0 PLACES	±	DRWN: M.NABEI 2004/04/28		SD-52018-001 PSD 001 A	
		ANGULAR TOL	± °	APPR: M.SASAO 2004/04/28		MATERIAL NUMBER CUSTOMER	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIRD ANGLE PROJECTION		DRAWING	SERIES	SHEET NUMBER	
		A3-SIZE		52018	SEE TABLE	GENERAL MARKET 1 OF 1	